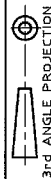


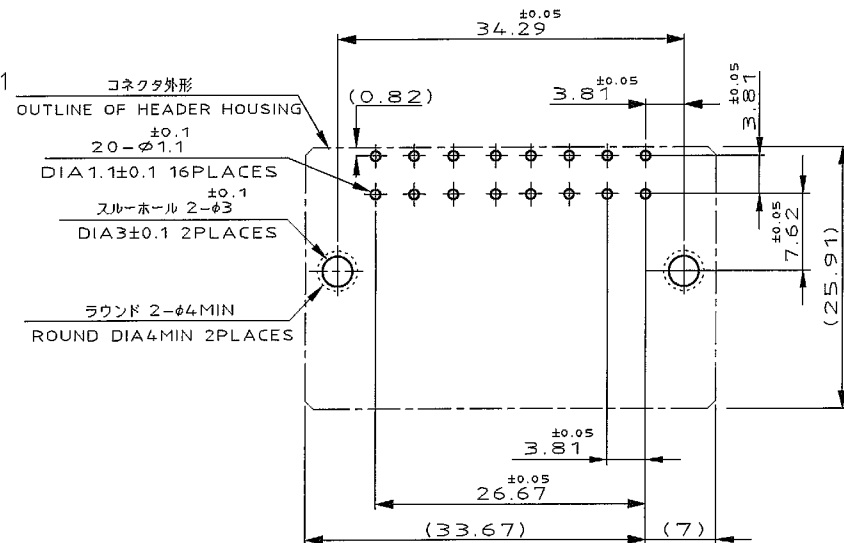
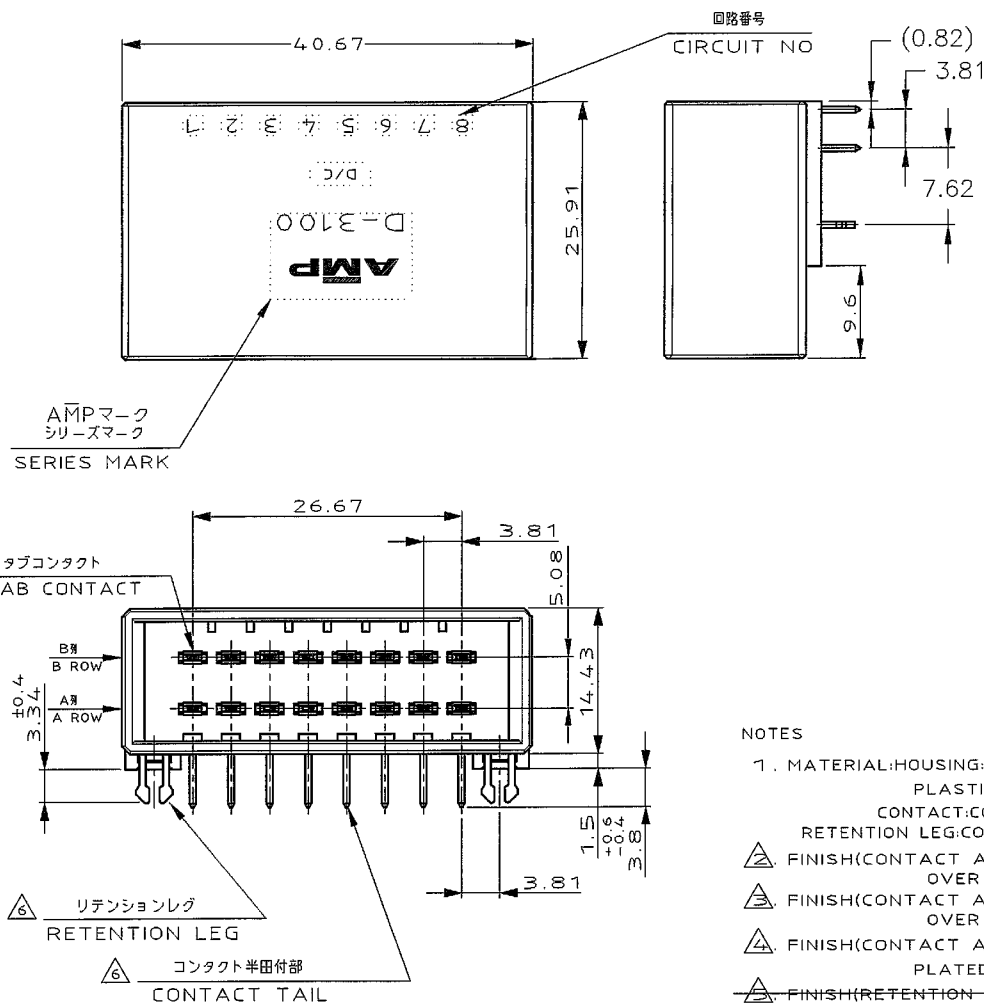
NUMBER 178307



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178307-5
△6	△3	178307-3
△6	△2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C	REVISED (FJDO-0039-03)	T.S.H.	4/15/05
B	REVISED (FJDO-0097-03)	T.S.M.	4/15/05
A	REDRAWN (FJDO-2183-95)	K.I.S.M.	3-23/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK

Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
MATERIAL	FINISH	ダイナミック D3100 水平タイプ 16 極 ヘッドアップセンサ	
SEE NOTE		16 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
DR.	DE.	SIZE	LOC
DR. 16/MAR/95 K.I.KEDA	DE. 16/MAR/95 K.I.KEDA	A3	J
CHK.	APP.	SCALE	REV.
CHK. S. MANTBE	APP. S. MANTBE	2-1	C
		SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面